

No. JE11-EP-23009

報道機関各位

2023年9月27日

株式会社ジーダット

ジーダットが Lorentz Solution, Inc. と販売代理店契約を締結

株式会社ジーダット（本社：東京都中央区、取締役社長：松尾和利、以下「ジーダット」）は、最先端のテクノロジーソリューションを提供する Lorentz Solution, Inc.（本社：3375 Scott Blvd, Suite 105 Santa Clara, CA 95054 United States, Founder and CEO: Jinsong Zhao、以下「Lorentz」ローレンツ）と販売代理店契約を締結いたしました。

ジーダットは、半導体設計分野において、先端のテクノロジーを活用したアナログ設計自動化ソフトウェアを提供する EDA (Electronics Design Automation) ベンダーです。この度、Lorentz の持つ、EDA ツールとシームレスに融合する電磁界解析プラットフォームを中心とした革新的な製品技術と優れたサービスの販売代理店として相互協力することで、お客様に新たな付加価値をご提供できるものと確信しております。

5G 時代の到来、さらに次世代の大容量無線通信ネットワークへの展開が切望される中、無線通信システムや端末、あるいは超高速データ通信システム開発への期待は非常に高まっています。大容量無線通信ネットワークを実現するためにはミリ波、さらにはテラヘルツ (THz) といった超高周波領域で動作する半導体デバイスが重要かつ不可欠な構成要素となります。Lorentz が提供する設計プラットフォームは、LSI からパッケージ・基板に至るまでのデバイス設計・検証のシミュレーションを高精度で実現します。同社の製品技術は、次世代の大容量無線通信ネットワークの実現に向けてますます重要性を増し、先進的なソリューションは多くの企業にとって不可欠な存在となっています。

IC 設計・検証に電磁界解析を取り入れた EDA ソフトウェアプラットフォームをいち早く開発した企業であり、その優れた技術は全世界の無線システム・IDM・ファウンドリのトップ企業に高く評価、採用されており業界内での地位を確立しています。

今回、ジーダットと Lorentz は、ますます高度化・複雑化するお客様のニーズに応えるため協力関係を強化し、両社のノウハウを結集し、新たな価値を創造、提供してまいります。

【会社概要】

株式会社ジーダット

設立：2004年

事業内容：半導体やディスプレイ設計向け設計自動化ソフトウェアの開発・販売・サポート、および半導体設計受託業務

所在地：〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲

代表者：取締役社長 執行役員 松尾 和利

URL：<https://www.jedat.co.jp/>

Lorentz Solution, Inc

設立：2003年

事業内容：IC 設計・検証に電磁界解析・シミュレーション技術を応用し、高周波オンチップ素子の設計やモデル作成を目的とした EDA ソフトウェアプラットフォーム製品の開発

所在地：3375 Scott Blvd, Suite 105 Santa Clara, CA 95054 United States

代表者：Founder and CEO: Jinsong Zhao

URL：<https://www.lorentzsolution.com/>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジーダット

<https://www.jedat.co.jp/contact/>

電話：03-6262-8400（代）

以上

【補足資料】

■製品

PeakView(TM) プラットフォーム

IC の設計・検証に使用する EDA ツールとシームレスに融合する電磁界解析プラットフォームです。レガシーから最先端まで、全ての PDK に適用することが可能です。

PeakView(TM)は Lorentz 社のフラッグシップ製品として、半導体製品に電磁界解析技術を適用した設計・検証ならびにシミュレーションを行う優れたソリューションを提供し、全世界の無線システム・IDM・ファウンドリのトップ企業にご活用いただいています

次世代の無線通信規格に適合した携帯電話・無線デバイスやミリ波・テラヘルツ技術を適用したチップを開発されている企業の皆様においては、最高のコストパフォーマンスを発揮するための設計の最適化・機能集積・またシグナルインテグリティの改善に大いに役立てていただけます。

大きな特長として、以下の技術を使用しています。

- ・ DC からミリ波、テラヘルツ (THz) 領域まで解析する三次元電磁界解析ソルバ
- ・ 大規模な構造を一括して解析可能なソルバ技術
- ・ 半導体設計に必要な PDK や EDA ツールと密接に連携する機能

製品は大きく以下の 4 つから構成されます。



EMD: パラメトリックに高周波回路部品のモデルを生成

LEM: レイアウトデータを基に、DC からテラヘルツ領域までの高精度モデルを抽出

HFD: アナログ・RF およびミリ波領域における寄生 RC 抽出フローをインダクタンス抽出まで拡張

PKG/PCB: TSV を含む 3DIC およびチップ-PKG-PCB の協調シミュレーション

以上